

## PASTA PARA SOLDAR QUE NO NECESITA LIMPIEZA NC254

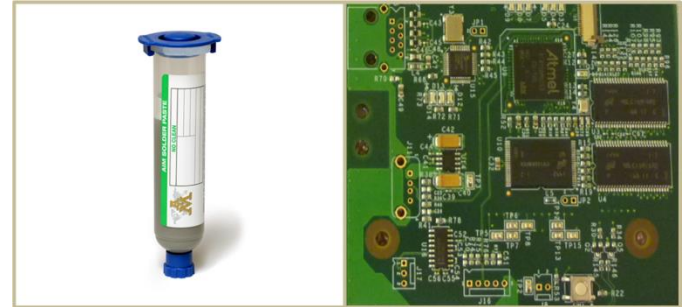
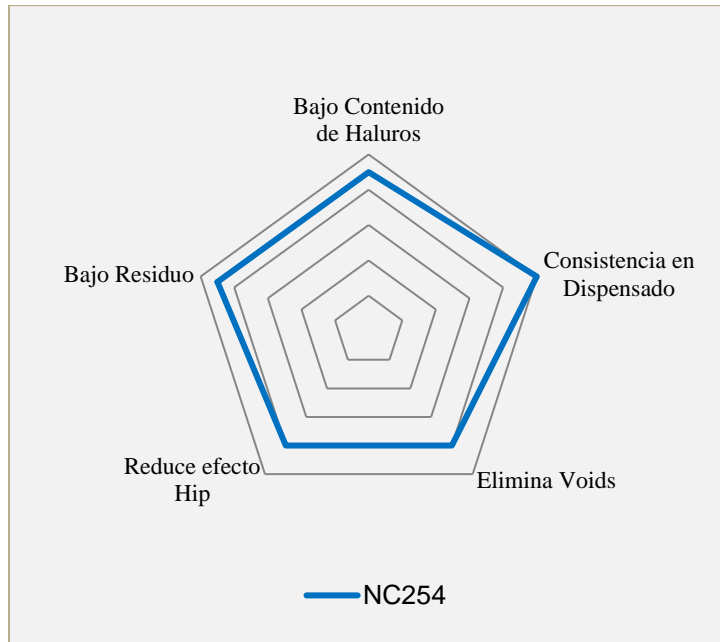
### CARACTERÍSTICAS

- Diseñada para Aplicaciones de Dispensado.
- Bajo Residuo de Flux y no Interfiere con las Pruebas Eléctricas.
- Libre de Haluros/Halógenos – Cumple normas REACH/RoHS
- Excelente Acción Humectante y Mojado de Soldadura.
- Minimiza la Generación de Vacíos y/o Huecos en Micro-BGA.
- Tiempo de Retención de superior + 8 Horas.

### DESCRIPCION

La soldadura en pasta NC254 ha sido especialmente desarrollada para proporcionar depósitos de soldadura confiable y consistente con sistemas de desplazamiento positivo y dispensadores de tipo neumático. La fórmula de la soldadura en pasta NC254 fue diseñada para soportar los requerimientos únicos de soldadura de pasta como procesos de dispensado por ciclos mecánicos repetidos y conservar sus características físicas, además proporciona una excelente acción de mojado y bajo residuo de flux después del reflujo que no interfiere con las pruebas eléctricas. La fórmula de la soldadura en pasta NC254 ha demostrado reducir la generación de huecos/vacíos en dispositivos con terminales bajo el componente, QFN, BGA y micro-BGA.

### CARACTERÍSTICAS



### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Aleación	Parámetro	Tiempo	Temperatura
Libre de Plomo	Vida útil en Refrigeración	9 Meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Libre de Plomo	Vida útil sin Refrigeración	4 Meses	< 25°C (< 77°F)
Con Plomo	Vida útil en Refrigeración	12 Meses	0°C-12°C (32°F-55°F)
Con Plomo	Vida útil sin Refrigeración	N/A	N/A

NC254 se envasa en contenedores tip EFD 5, 10 y cartuchos de 30cc. Los cartuchos deben almacenarse con la punta hacia abajo cuando sea posible. La soldadura en pasta una vez utilizada, no debe ser vuelta a refrigerar. Cualquier signo de separación visible del flux, el cartucho debe ser desechado. Vea las guías de manejo de la pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC254 para información específica del producto.

### LIMPIEZA

El sistema de dispensado de la soldadura en pasta NC254 puede limpiarse con alcohol isopropílico. No deje residuos de la soldadura en la válvula o conductos del sistema de dispensado durante la noche o después de paros de más de 12 hrs. Acondicionadores para válvulas pueden ser utilizados para eliminar la necesidad de limpiar el equipo.

**Residuos Post-Reflujo:** Los residuos la soldadura en pasta NC254 de AIM pueden permanecer sobre el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. Cuando un proceso limpio sea requerido, los residuos pueden ser eficazmente removidos con los agentes de limpieza comunes de la industria. Comuníquese con AIM para obtener mayor información sobre procesos limpios.

## GUIA DE PROCESOS PARA DISPENSADO

La selección de la punta del dispensador es crítico para el éxito en el dispensado de la pasta de soldadura. Es recomendable seleccionar la punta de diámetro interno más grande inicialmente para alcanzar el tamaño deseado para el depósito con el fin de utilizar menos presión. Se recomienda el uso de puntas cónicas de plástico con dispensadores neumáticos. Cuando se utilizan puntas de metal, Se recomienda usar la punta con menor longitud en la medida de lo posible ya que ayudara a aumentar el rango de presión. En dispensadores neumáticos, no se debe exceder los 40 psi (2.75bar) de presión ya que puede ocasionar la separación de la pasta.

## PERFIL DE REFLUJO

Toda la información del perfil se puede encontrar en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Póngase en contacto con AIM para obtener información adicional.

## DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de IPC	J-STD-004	ROLO	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	Bajo	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASO	
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	Sin Fluoruros	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	Información disponible a solicitud
Electromigración / Bellcore	J-STD-004 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1 GR-78-CORE	PASA	Información disponible a solicitud
Contenido de Sólidos No Volátiles en el Fundente.	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	96.7% Típico	
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	114 mg KOH/ g Típico	
Viscosidad	J-STD-004B 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	300-400 Kcps	
Inspección Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa	
Prueba colapsa miento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	34.2 gf Típico	